산업통상자원부 http://www.motie.go.kr	보 도 자 료	보다 나은 정부

2018년 8월 31일(금) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.
(인터넷, 방송, 통신은 8. 30.(목) 오전 11시 이후 보도 가능)

배포일시	2018. 8. 30.(목)	담당부서	전자부품과
담당과장	박영삼 과장(044-203-4270)	담 당 자	김성환 주무관(044-203-4276)

전자부품산업 신시장 창출을 위해 수요산업 연계 확대
[전자부품 융합 얼라이언스 IoT가전분과 출범]

□ **(행사개요)** 산업통상자원부는 **'18. 8. 30(목) '글로벌R&D센터**(성남)'에서 **'전자부품 융합 얼라이언스 : 사물인터넷(IoT)가전분과' 출범식과 업계 간담회**를 개최했다.

○ 이번 행사는 기 출범한 **자동차 분과(5월), 바이오·의료기기분과(6월)에 이은 3번째 시리즈**로,

- 반도체·디스플레이 업계와 수요산업인 사물인터넷(IoT) 가전기업 간 **상시적으로 소통 할 수 있는 만남의 장**을 만들기 위한 것이다.

- 특히 이번 **사물인터넷(IoT) 가전분과**에서는 반도체·디스플레이기업 뿐만 아니라 내장형소프트웨어(**임베디드SW**) **및 센서기업을 추가해 전자부품산업 전반에 걸친 협력체계 구축**이 기된다.

< 행사 개요 >

○ **(일시 / 장소)** '18.8.30(목) 15:00~16:30 / 글로벌R&D센터(경기 성남)

○ **(참석자)** 산업부 강경성 소재부품산업정책관, 전자부품연구원, 한국전자정보통신산업진흥회, 임베디드소프트웨어·시스템산업협회, 한국반도체산업협회, 한국디스플레이협회, 중소·중견기업 임직원 등 약 30여명

□ **(시장현황)** 세계 사물인터넷(IoT)가전 시장(NR, '15)은 ('15) 52억 달러 → ('19) 233억 달러로, 사물인터넷(IoT) 가전을 매개로 한 스마트홈 국내시장(스마트홈산업협회, '15)은 ('15) 10조 원에서 연평균 20%대 성장세로 ('19) 21조 원 규모로 확대가 예상된다.

○ 이런 성장세에 맞춰 **해외 기업은 사물인터넷(IoT) 기반 스마트 가전 제품과 제휴*** 등으로 생태계 구축과 시장 선점을 목표로 투자하고 있다.

* (구글) 온도조절장치 등을 만드는 네스트랩스 인수, (애플) IoT가전 개발 도구인 홈킷(HomeKit) 공개

□ **(사물인터넷(IoT) 가전분과 의의)** 최근 가전산업은 단순 기능에서 벗어나 인공지능(**AI**)·**빅데이터가 결합된 사물인터넷(IoT) 가전**으로 진화 중이며,

○ **사물인터넷(IoT) 가전의 경쟁력**은 가전제품에 내장되는 **전자부품**(반도체·디스플레이·임베디드SW·센서)**의 경쟁력에 크게 의존**할 수밖에 없다.

* ex) IoT가전분야가 성장하면서 **IoT반도체는 핵심부품으로써 '20년까지 연평균 약 25% 고속 성장** 전망(Gartner)

try of Trade,
try and Energy



○ 이에 산업부도 **사물인터넷(IoT) 기업과 수요기업(가전) 간 상시적 시장 창출을 지원할 계획이다.**

최미화 / 홍보담당관 / 2018-08-30 14:43:37

□ **(핵심내용)「전자부품 융합 얼라이언스」**는 기본적으로 **업계 자발적으로 운영**되며, **정부는 연구개발(R&D), 해외진출** 등을 지원할 계획이다.

① 구성원을 한정할 경우 지속가능성과 확장성에 어려움이 있을 수 있어 **구성원을 상시 모집**하는 오픈 얼라이언스(**Open Alliance) 형태로 운영**

② 전자부품산업 지원을 위해 **'19년 신규 연구개발(R&D)사업(안)*에 업계 의견이 반영**될 수 있도록 운영할 계획

* 차세대반도체개발사업('19년 신규, 150억원), 산업용임베디드시스템기술개발('19년 신규, 17억원), 디스플레이 혁신공정 플랫폼 구축사업 (예비타당성 조사 중)

③ 참여기업에게 자신들이 보유한 **새로운 비즈니스 모델 및 아이템을 홍보**할 수 있는 기회*를 제공

* 1:1 기업매칭 행사, 최종 수요기업 제품 홍보 등(연중)

④ **해외 진출 지원**을 위해 각 산업별 글로벌 수요기업과 연계할 수 있도록 **글로벌 네트워킹 플랫폼 시리즈*에 참여**

* 예시) 폭스바겐, GE 등 글로벌 기업과 국내 반도체·임베디드SW 업계와 연계

□ 강경성 소재부품산업정책관은 인사말을 통해,

○ 사물인터넷(IoT) 가전 신시장창출을 위해 전자부품업계와 가전업계의 협업이 큰 역할을 할 것으로 기대하며,

○ 융합얼라이언스를 통해 **성공사례를 마련할 수 있도록 업계의 적극적인 참여**를 부탁하고, 정부도 **지속적으로 관심을 갖고 정책적으로 지원**하겠다고 말했다.

【붙 임】 1. 행사 개요 2. 얼라이언스 참여기관 현황

이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 전자부품과 김성환 주무관(☎ 044-203-4276)에게 연락주시기 바랍니다.

붙임1 **행사 개요**

□ **행사 개요**

○ (목적) 전자부품 융합 얼라이언스 **IoT가전분과 운영을 위한 출범식 및 업계 의견 청취를 위한 간담회 개최**

○ (일시/장소) '18.8.30일(목) 15:00~16:30 / 글로벌R&D센터(성남)

○ (참석자) 산업부, 전자부품연구원, 한국전자정보통신산업진흥회, 한국반도체협회, 한국디스플레이협회, 임베디드SW시스템산업협회 등

○ (주요내용)

- 전자부품 얼라이언스 운영계획 발표
- 참여기업 간담회

try of Trade,
try and Energy

□ **세부 계획(안)**

시 간	내 용	비 고
15:00~15:05(05')	- 인사말씀	· 소재부품산업정책관
15:05~15:20(15')	- 얼라이언스 출범 그간 경과 및 향후 계획 발표	· 전자부품연구원
15:20~16:20(60')	- 얼라이언스 신청기업 간담회	· 참석자
16:20~16:25(5')	- 마무리말씀	· 소재부품산업정책관
16:25~16:30(5')	- 기념촬영	· 참석자

최미화 / 홍보담당관 / 2018-08-30 14:43:37

붙임2 전자부품 융합 얼라이언스(IoT가전분과) 참여기관 현황

○ 가전·반도체·디스플레이·임베디드SW·센서기업, 관련 협·단체 및 연구기관 등으로 구성

구분	소속	성명	직책	비고
참여기업	대유위니아/대우전자	김동원	실장	가전(5)
	오텍캐리어	김덕규	팀장	
	코웨이	노형주	팀장	
	쿠쿠전자	김종학	팀장	
	SK매직	최희광	팀장	
	라온텍	조성재	전무	반도체(4)
	아이언디바이스	박기태	대표	
	어보브반도체	이희연	이사	
	엠씨에스로직	김찬식	상무	
	아바코	김태윤	과장	디스플레이(3)
	케이엔더블유	김영삼	책임	
	파인텍	서인용	부장	
	구름네트웍스	김성민	기술이사	임베디드SW(5)
	그립	정연규	사장	
	한컴MDS	이종영	상무	
	FA리눅스	유영창	대표	
	GKES	박종섭	사장	
	센텍코리아	유도준	대표	센서(3)
	엔아이디에스	황학인	대표	
	햅트릭스	서영호	상무	
참여기관	한국전자정보통신산업진흥회	이승정	과장	
	한국반도체산업협회	안기현	상무	
	한국디스플레이산업협회	서광현	부회장	
	임베디드SW·SYSTEM산업협회	김은선	팀장	
	한국산업기술평가관리원	김성호	팀장	
주관기관	전자부품연구원	성하경	선임연구본부장	
	전자부품연구원	강병모	기업협력본부장	